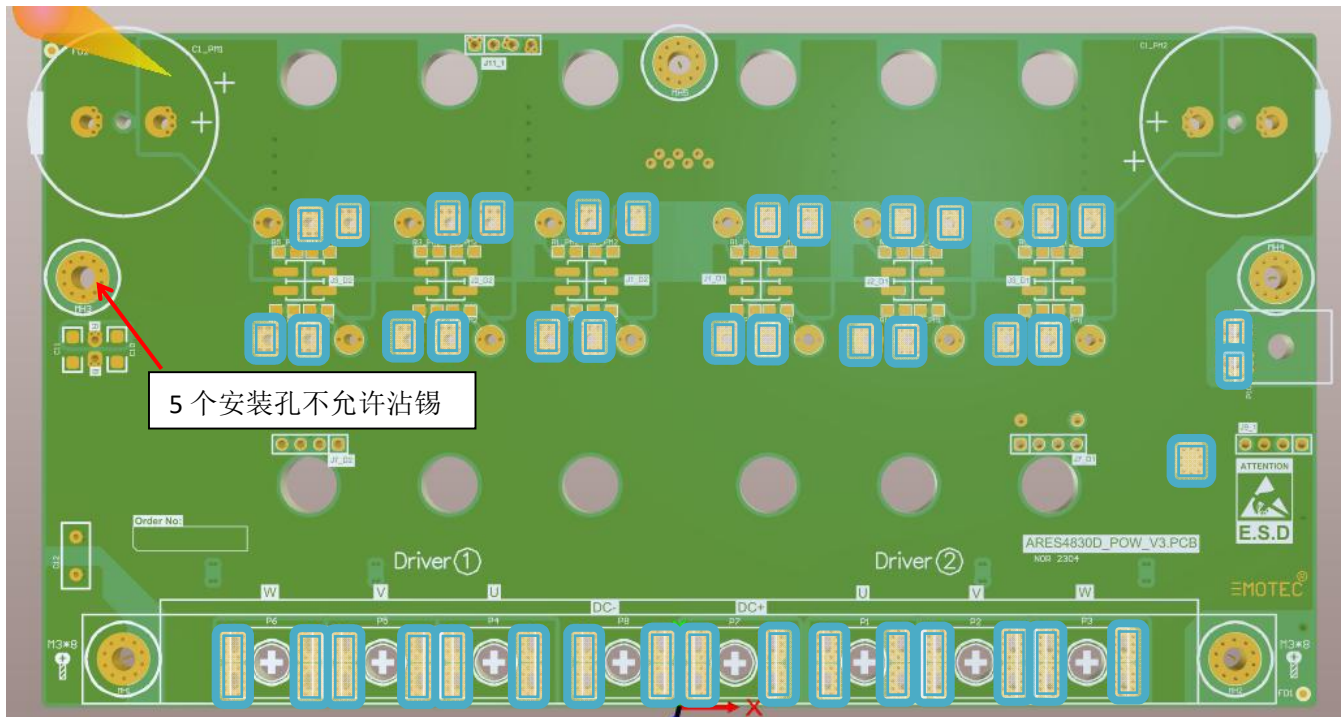



PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	版本	页数	制订时间
	直流伺服	ARES4830D_POW_V4	焊接	V4	1/2	20231230

1. 加锡位置(即除元件焊盘外, 所有裸露焊盘[露铜位置]进行加锡)

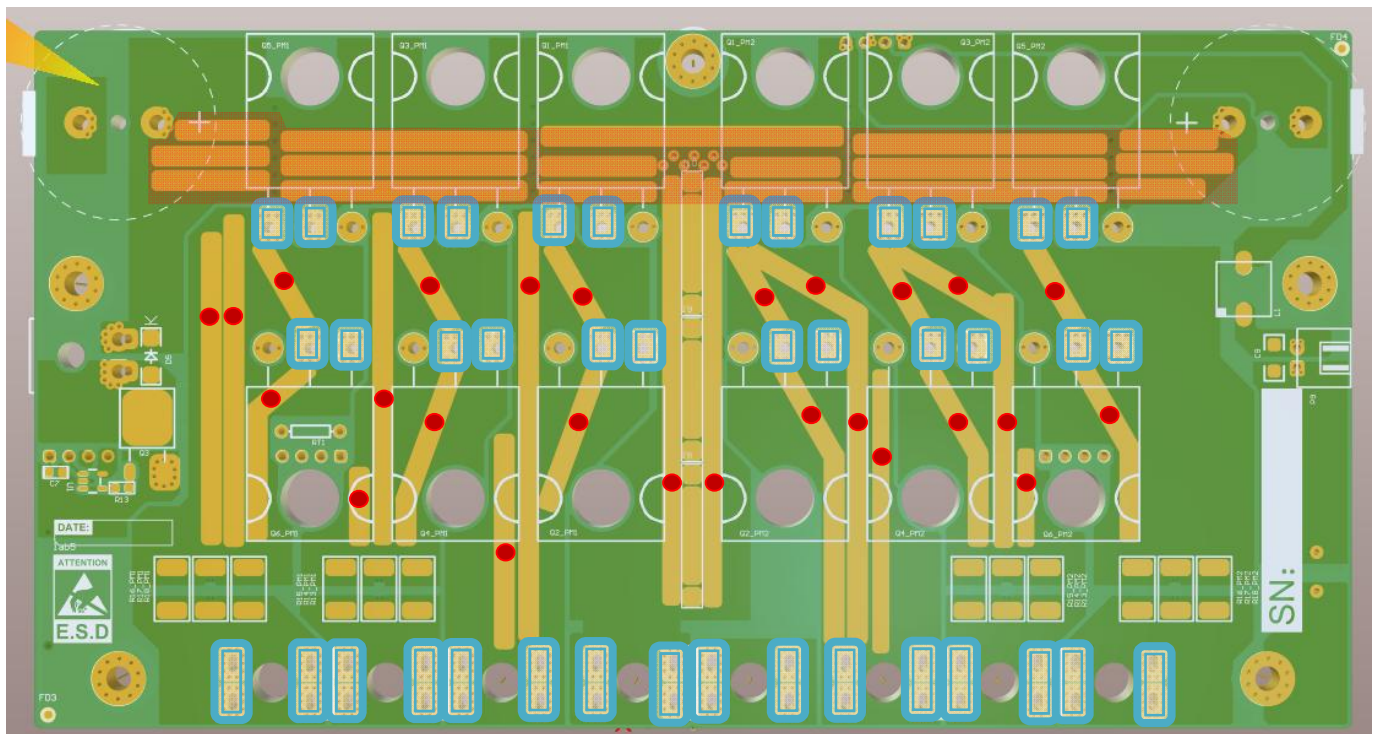
顶层


层



-  蓝色双线框内半透明覆盖的 PAD 区, 要求每个通孔内上下焊锡通透 (灌满焊锡、淹没过孔即可);

底层

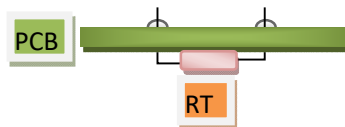


- 1) 上图底层红色半透明框内及 ● 所标注的矩形加长 PAD 加锡, 加锡厚度为 0.2mm;
- 2)  蓝色双线框内半透明覆盖的 PAD 区, 要求每个通孔内从底层至顶层注满焊锡 (淹没过孔即可);

PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序		版本	页数	制订时间
	直流伺服	ARES4830D_POW_V4	焊接		V4	2/2	20231230

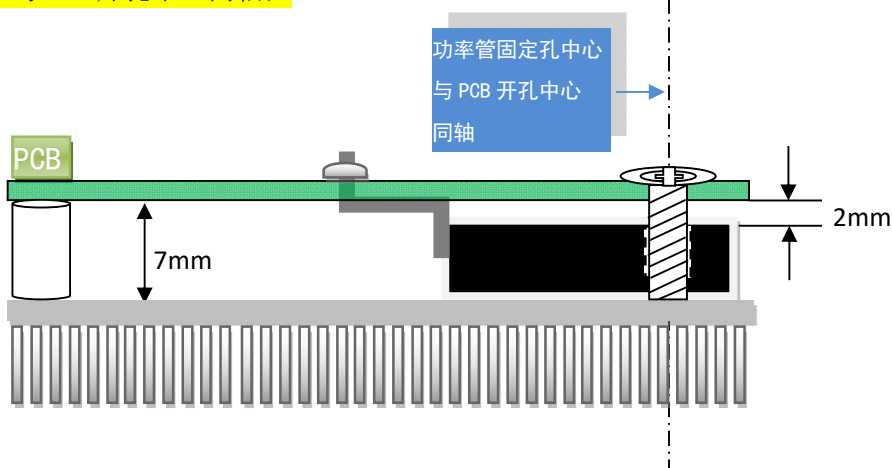
2. P1~P8 功率端子焊接，要求压到底，完全浸润焊锡，严禁虚焊，空焊；

3. 温感热敏电阻 RT1 紧贴 PCB 的下表面焊接（见右图）；



4. 功率管 Q1_PM1~Q6_PM1 及 Q1_PM2~Q6_PM2 共计 12 个（TO-247 封装的管子），管脚直角折弯

- a) 高度：功率管的下表面（金属部分）距离 PCB 下表面 7mm 焊接；且要求功率管脚顶层和底层双面焊接；
- b) 焊接后，功率管固定孔中心与 PCB 开孔中心同轴；



5. 其他焊接要求：

- 1) 所有端口插座焊接需要压到底焊接，不接受歪扭，偏差要小于 0.3mm；
- 2) 所有极性元件，严禁方向反；
- 3) 测试点及 MARK 点，严禁沾锡
- 4) 不接受虚焊，空焊，焊锡短路；
- 5) 未特殊说明的元件，均紧贴线路板焊接；
- 6) 手工操作要做防静电处理；
- 7) 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准；
- 8) 贴装元件位置图详见焊接丝印图文件

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	